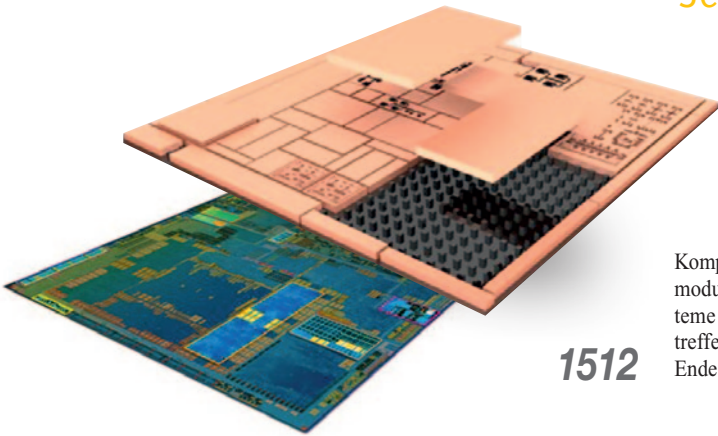


INHALT

September 2018



Komplexe Systems-on-Chip werden künftig durch modular aus sogenannten Chiplets aufgebaute Systeme abgelöst. Das wurde beim DARPA-Gipfeltreffen Electronics Resurgence Initiative Summit Ende Juli in San Francisco deutlich

1512



Bauteile aus China: Die Moskauer ChipEXPO bringt Elektroniker beider Länder zusammen



Mit einer neuen Softwarelösung beschleunigt T-Systems die Auswertung großer Datenmengen



Prototypenfertigung: Für den EMS-Dienstleister lukrativ, wenn der Maschinenpark stimmt

EDITORIAL

Sicherheit ist ein Thema – Leistung aber auch 1409

AKTUELLES

Nachrichten/Verschiedenes 1413
 Entkomplizieren durch Dialog und Information 1426
 Tagungen/Fachmessen/Weiterbildung 1429
 Neue Normen 1435

BAUELEMENTE

ChipEXPO 2018 – Russlands und Chinas
 Elektronikindustrie sollen stärker zusammenrücken 1436
 Galliumoxid als Basis für neuartige,
 hocheffiziente Leistungshalbleiter 1440

BAUELEMENTE

SMD-Strommess-Widerstände 1443
 Breite Auswahl von XP Power 1443
 Neue N-Kanal SiC-Leistungs-MOSFETs bei Schukat 1443

DESIGN

Neue Software versteht den Erklönig besser 1446

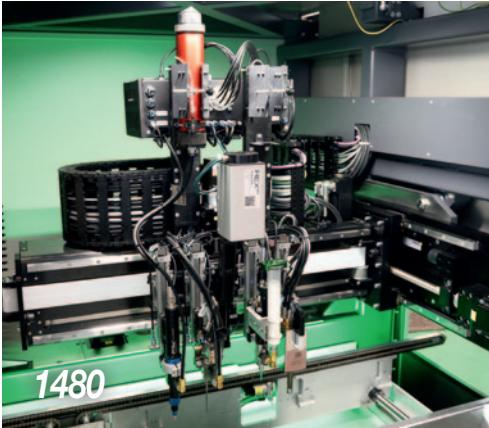
LEITERPLATTENTECHNIK

Auf den Punkt gebracht (H. J. Friedrickheit):
 Medizintechnik und Elektronik: Ein anspruchsvoller
 Wachstumsmarkt mit Zukunft 1457
 Prototypentechnik fordert Aktualität 1467
 Verbessertes Alukern-Angebot 1469



ventec
INTERNATIONAL GROUP
騰輝電子

*Flexible, zuverlässige
Supply-Chain-Lösungen
Qualitative hochwertige
Basismaterialien
und Prepregs*



Eine Protecto-Anlage trägt Acryl-Schutzlack auf: Beim Coating arbeiten Rehm und Electrolube eng zusammen

LEITERPLATTENTECHNIK

CNC-Steuerung für Bohren und Fräsen von Leiterplatten 1470

BAUGRUPPEN & SYSTEME

Allotentsorgung: Nicht nur eine Frage der Asche, sondern auch der Rechtssicherheit 1477

Rehm und Electrolube: Coating leicht gemacht 1480

Montage von Kamera-Sensoren im Reinraum 1482

Thermosonisches Drahtbonds auf galvanisch abgeschiedenen Oberflächen – Teil 1 1485

ANALYTIK & TEST

Von Boundary Scan zu Embedded JTAG Solutions 1496

Künstliche Intelligenz und inspirierende Lösungen 1499

KI-Implementierung in der AOI 1503

Automatische Baugruppenprüfung jetzt in Minuten 1504

Selbstprogrammierende 3D-Inspektionssoftware 1506

Automatisierte Zählung von SMD-Rollen 1507

FORSCHUNG & TECHNOLOGIE

AMD revolutioniert mit Chiplets und neuen Chip-Netzwerk-Strukturen die Computertechnik 1512

PLUS 9/2018 | 1411



Ventec ist Spezialist für die Herstellung von hochwertigen Basismaterialien und Prepregs. Unser globales Vertriebsnetz liefert kundenspezifische Supply-Chain-Lösungen in alle Regionen der Welt.

Mit komplett ausgestatteten Service-Zentren in China, Großbritannien, Deutschland und den USA ist niemand besser positioniert, um die Bedürfnisse der globalen Leiterplattenindustrie zu bedienen.

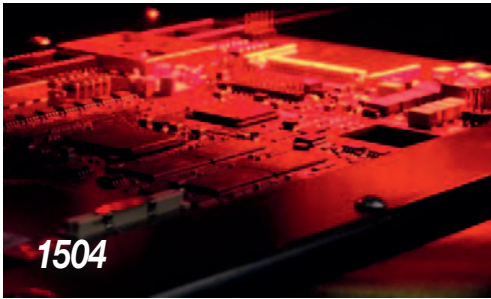
Ventec International Group

T: +49 (0)6352 75326-0

E: contact@ventec-europe.com

T: Follow @VentecLaminates

www.ventec laminates.com



Mit selbstprogrammierender Software für SPI und AOI beschleunigt die Saki Corporation die Erstellung von Prüfprogrammen enorm

FORSCHUNG & TECHNOLOGIE

Patente	1520
Diamantscheibe mit Rekorddurchmesser von 180 Millimetern	1521

FORUM

Microelectronics Saxony – Bausteine für die Energiewende	1524
Kolumne: Die Angst geht um	1531
PLUS-Firmenverzeichnis	1535
Im Heft redaktionell erwähnte Firmen	1563
Inserentenindex	1564
Mediadaten	1565
Impressum	1567
Produkt des Monats	1568

Titelbild

BJZ ist seit Jahrzehnten ein zuverlässiger und kompetenter Partner der Elektronikindustrie. Durch langjährige Erfahrung haben wir uns als innovatives und expandierendes Unternehmen in den Bereichen des EGB-Schutzes, der Bauteilvorbereitung und der Nutzentrenntechnik eine solide Marktposition gesichert. Führende Unternehmen der Elektronikindustrie vertrauen seit Jahren auf die Fachkompetenz und Produkte der Firma BJZ.

www.bjz.de

Die Fachzeitschrift PLUS ist das Organ folgender Fachverbände:



Fachverband Bauelemente Distribution e.V.
Tel. +49 8563 9788908
w.ziehfuss@fbdi.de, www.fbdi.de

1444



Fachverband Elektronik-Design e.V.
Tel. +49 30 340 60 30 50
info@fed.de, www.fed.de

1449



EIPC – Der Europäische Elektronik-Verband
Tel. +31 46 4264258
www.eipc.org

1462



Fachverband Electronic Components and Systems
Tel. +49 69 6302-276 bzw. -251
zvei-be@zvei.org, www.zvei.org

1472



Fachverband PCB and Electronic Systems
Tel. +49 69 6302-437
PCB-ES@zvei.org, www.zvei.org



INTERNATIONAL MICROELECTRONICS AND PACKAGING SOCIETY – Deutschland e.V.
Tel. +49 3677 69-3381
martin.schneider-ramelow@imaps.de
www.imaps.de

1491



Forschungsvereinigung Räumliche Elektronische Baugruppen 3-D MID e.V.
Tel. +49 911 5302-9100
info@3dmid.de, www.3dmid.de

1508



DVS – Deutscher Verband für Schweißen und verwandte Verfahren e.V.
Tel. +49 211 1591-0
michael.weinreich@dvs-hg.de
www.dvs-ev.de

1523